

2024第十二届半导体产业及应用展览会将在4月9日召开!

产品名称	2024第十二届半导体产业及应用展览会将在4月9日召开!
公司名称	尹宸会展服务(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1393室F座(注册地址)
联系电话	17521731414

产品详情

2024第十二届深圳国际半导体产业及应用展览会

时间:2024年4月9-11日 地点:深圳会展中心(福华三路)

组织机构

指导单位:工业和信息化部

深圳市人民政府

主办单位:中国电子器材有限公司

支持单位:中国电子元件行业协会

中国电子仪器行业协会

中国电子质量管理协会

中国电子专用设备工业协会

中国电子学会通信分会

中国半导体行业协会

中国光学光电子行业协会光电器件分会

中国光学学会激光加工专业委员会

中国真空电子行业协会

江苏省半导体行业协会

浙江半导体行业协会

陕西省半导体行业协会

天津市集成电路行业协会

大连市半导体行业协会

宁波电子行业协会

承办单位：中国电子信息博览会有限公司

深圳业威会展有限公司

招展单位：深圳励辰国际展览有限公司

广东省半导体行业协会

展会介绍

中国半导体产业将顺势而为，逆势崛起

随着人工智能、智能汽车、无人机、汽车电子、安防、物联网、手机、消费及穿戴电子、家电、电源、5G通信等新技术的快速发展，推动了对于半导体需求的持续快速增长，为全球半导体行业增添了新的动力。作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球大和贸易活跃的半导体市场。再加上中国政府对于半导体行业的大力扶持，中国半导体行业发展呈加速态势。“十四五”期间，我国半导体产业将有更全面的发展，并将加快高端芯片设计等领域关键核心技术的突破和应用。

作为中国科技创新中心，深圳是我国半导体产品的集散中心、应用中心和设计中心，深圳的半导体产业多年来一直保持高速增长态势，特别是IC设计产业一直位于全国前列。近年来，国内对半导体产业重视力度空前，深圳正作为广东省主阵地打造全国半导体产业第三极，不断加大对半导体产业的政策与资金支持力度。2022年6月，深圳出台“20+8”产业政策，发布了《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》，提出加快完善集成电路设计、制造、封测等产业链条，推动开展EDA工具软件、半导体材料、高端芯片和先进制造等相关重点工程，推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设，高水平打造一批半导体与集成电路产业基地和产业园区。随着政策的发布与实施，在国内5G通信、新能源汽车、工业互联网、大数据、光伏等行业快速发展的大趋势下，以及“碳达峰、碳中和”绿色低碳战略不断推进，第三代半导体市场应用已逐步开启，产业规模不断壮大。

作为华南地区乃至全国的quanwei性、专业化半导体行业品牌盛会，2024深圳国际半导体展览会将于2024年4月9日-11日在深圳福田会展中心举办，本届展会预计展出面积70,000平方米，1200余家展商，预计观众人数达100,000+。本届展会专注于整合半导体行业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为半导体企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交

流和互通。作为兼具规模和影响力的半导体产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外半导体行业创造品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把握行业发展方向。共享国际化大平台，共拓半导体大市场，让我们携手同行，共创商机！

同期论坛

2024粤港澳大湾区半导体产业趋势论坛

2024珠三角第三代半导体产业技术峰会

2024深圳半导体材料及设备产业发展峰会

2024深圳半导体功率器件设计及集成应用论坛

2024深圳半导体封装封测产业技术峰会

2024深圳电子气体安全研讨会

2024深圳半导体投融资论坛

2024珠三角集成电路产业创新发展论坛

(具体论坛议程以现场为准)

日常安排

报到布展：2024年04月7-8日（09：00—17：00）开幕时间：2024年04月9日（09：00）

展出时间：2024年04月9-11日（09：00—16：30）闭幕时间：2024年04月11日（16：00）

展览范围

1、半导体设计、封测、制造产厂商等。

2、原材料：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、光掩膜版、电子气体及特种化学气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料等；

3、生产设备：单晶炉、氧化炉、扩散设备、离子注入设备、PVD、CVD、光刻机、蚀刻机、抛光机、倒角机、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备

4、单晶片、沉积系统、清洗设备等；

4、封装工艺及设备：减薄机、划片机、贴片机、焊线机、塑封机、打弯设备、分选机、测试机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备等；

5、测试与封装配套产品：探针卡、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液、划片液、封片膜(胶)高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板，焊线、liuliang控制、石英石墨、碳化硅等；

6、第三代半导体：第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件(发光二极管LED、激光器LD、探测器紫外)、电力电子器件(二极管、MOSFET、JFET、BJT、IGBT、GTO、ETO、SBD、HEMT等)、微波射频器件(HEMT、MMIC)等

7、IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC设计与设计工具、IC制造与封装等；

8、电子气体：集成电路、平面显示器件及其它电子产品生产的特种气体企业等；

9、半导体分立器件产品、半导体光电器件、集成电路终端产品等；

10、全国各地政府组团、半导体相关领域高科技产业园区、证券、银行、保险、基金、投资金融机构等。